

Anbefalt pad utlegg 0201 chiper

Basert på erfaring, tidligere forsøk og anbefalinger gitt i IPC 7351 ønsker vi å anbefale følgende utlegg for 0201 chiper.

IPC 7351 operer generelt med tre varianter disse er:

IPC-7351 Land Pattern Variations for Rectangular Two Terminal Devices



Density Level A
Very Robust
Solder Joint



Density Level B
General Purpose
Solder Joint

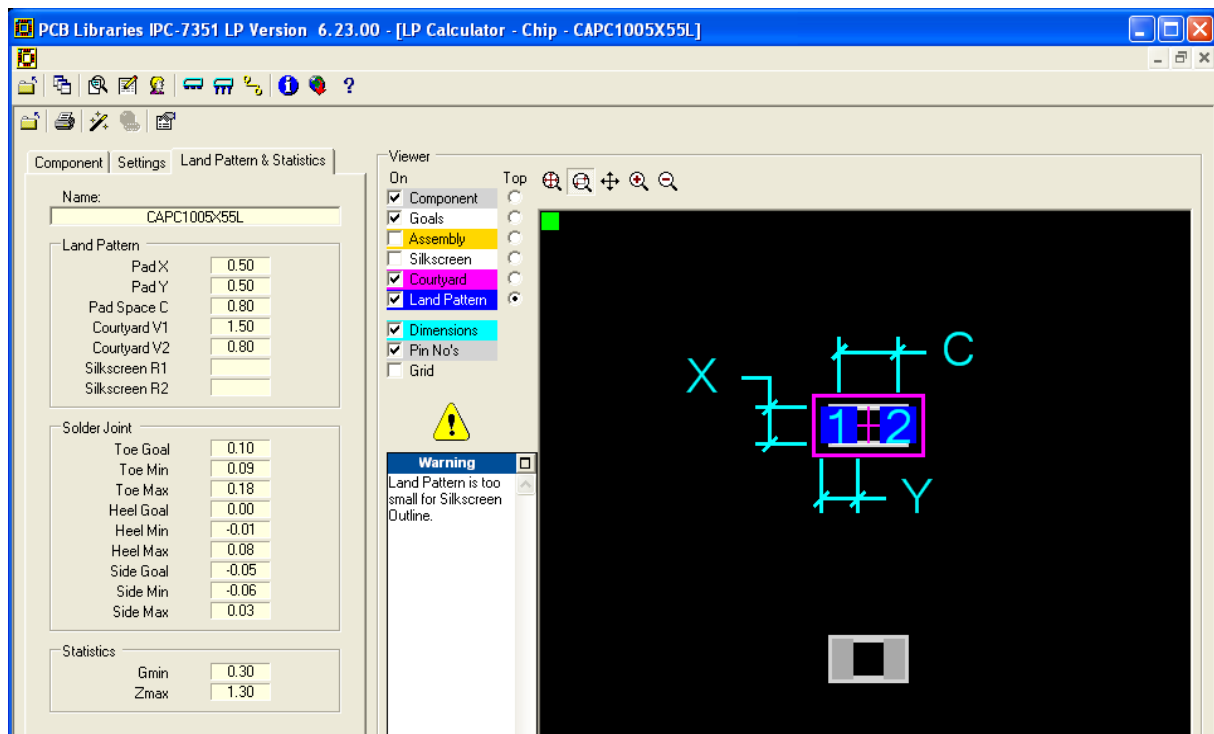


Density Level C
Minimal Solder Joint
for
High Density Applications

Density level A, kalles også "Most"

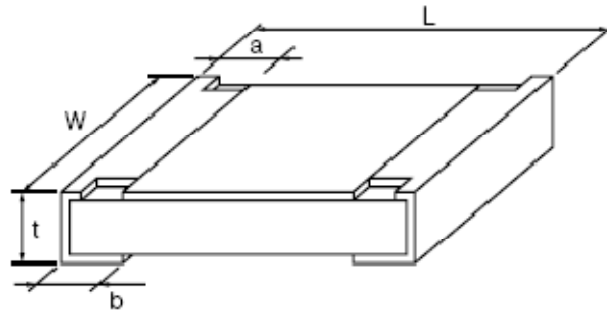
Density level B, kalles også "Nominal"

Density level C, kalles også "Least".



Eksempel fra 0402 padutlegg fra utleggskalkulatoren på IPC 7351:

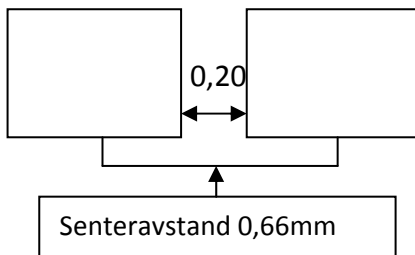
■ Dimensions in mm (not to scale)



Type (inches)	Dimensions (mm)					Mass (Weight) [g/1000pcs.]
	L	W	a	b	t	
ERJXG (01005)	0.40 \pm 0.02	0.20 \pm 0.02	0.10 \pm 0.03	0.10 \pm 0.03	0.13 \pm 0.02	0.04
ERJ1G, 1R (0201)	0.60 \pm 0.03	0.30 \pm 0.03	0.10 \pm 0.05	0.15 \pm 0.05	0.23 \pm 0.03	0.15

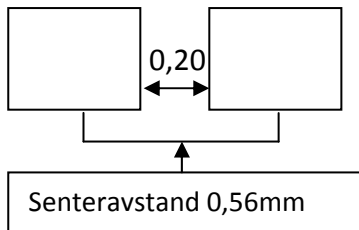
I datablad ser man at en 0201 er noe større enn hva man skulle tro.
 Lengde x bredde er (0,6 x 0,3) millimeter.
 (En tusendels tomme er 0,254mm)

IPC anbefalt utlegg på "Nominal"



Lengde på pad: 0,46mm
 Brekke på pad: 0,42mm

IPC anbefalt utlegg på "Least"



Lengde på pad: 0,36mm
 Brekke på pad: 0,32mm

Tilsvarende tall på "forsøk"

Lengde på pad: 0,36mm (+20% 0,40mm)
 Brekke på pad: 0,46mm
 Avstand mellom pader: 0,25mm